

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

500

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

29.07.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	150		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
C-RS-FR4-ML-0.41mm-070+070-TG150-HF	50200759	70	L2	4
		410		
		70	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	150		5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	7

Dicke nach Verpressen

B00:

890 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

990 µm

Dmin:

790 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1000 µm

Tol+:

100 µm

Tol-:

100 µm

Dmax:

1100 µm

Dmin:

900 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

920 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik